



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > DIMM 插槽 > DDR4 DIMM 插槽



DRAM 类型: **双倍数据速率 (DDR) 4**

连接器系统: **板对母排**

位数: **288**

PCB 端接方法: **表面贴装**

模块方向: **垂直**

[所有 DDR4 DIMM 插槽 \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板          |
| DRAM 类型   | 双倍数据速率 (DDR) 4 |
| 连接器系统     | 板对母排           |

结构特性

|      |     |
|------|-----|
| 位数   | 288 |
| 模块方向 | 垂直  |

主体特性

|       |    |
|-------|----|
| 弹射器类型 | 标准 |
|-------|----|

接触件特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子额定电流（最大值） | .75 A |
|-------------|-------|

端接特性

|          |      |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | .85 mm[.033 in] |
|---------|-----------------|



使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 硬托盘 |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | [DDR4 DIMM](#)

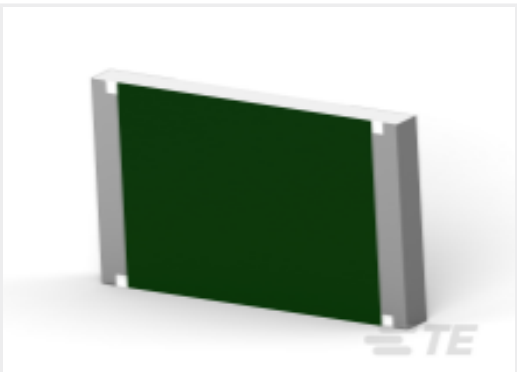


[DIMM 插槽\(25\)](#)



[SO DIMM 插槽\(39\)](#)

客户还购买了



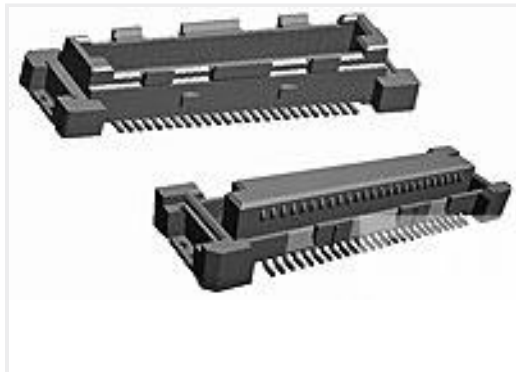
TE 产品编号2176406-9  
[3560 2R2 1%](#)



TE 产品编号1-1879128-4  
[RN 0402 604R 0.1% 10PPM 1K RL](#)



TE 产品编号2118721-4  
[STD SHIELD COVER, AL-38.60X25.90X2.00MM](#)



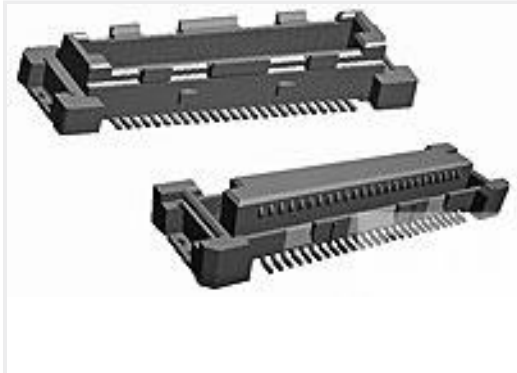
TE 产品编号1-5353727-0  
[.6FHP08H,280,B,GIG,08/Sn,ST,NSYes](#)



TE 产品编号2176403-2  
[3550 1R1 1%](#)



TE 产品编号NB18922001  
[RNF-100-1/16-YO-STK](#)



TE 产品编号1-5353729-0  
[.6FHR04H,280,B,GIG,08/Sn,ST,NSYes](#)



TE 产品编号2085958-1  
[ICCON,SIZE 4,LOCKING PIN ASSEMBLY](#)



TE 产品编号5-535512-2  
[112 MODII HORZ DR CE EESS .100](#)

文档

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-2199155-3\\_B1.2d\\_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-2199155-3\\_B1.3d\\_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-2199155-3\\_B1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本